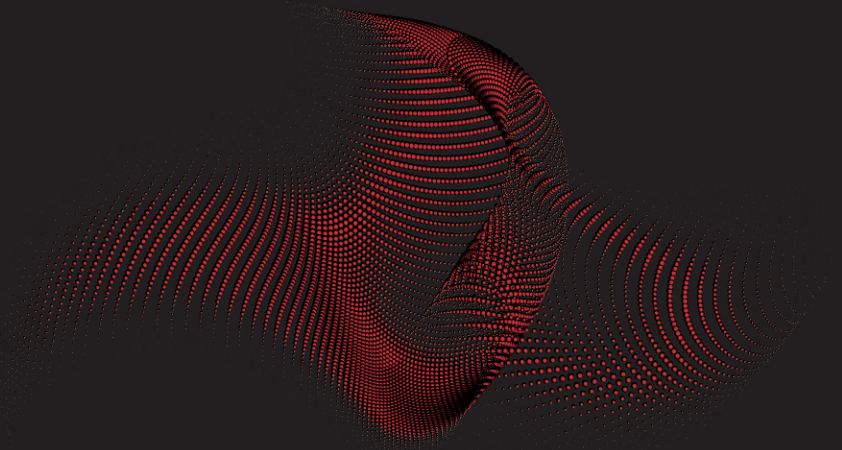


MIRAXIA

EDGE TECHNOLOGY

ミラクシア エッジテクノロジー株式会社
会社案内

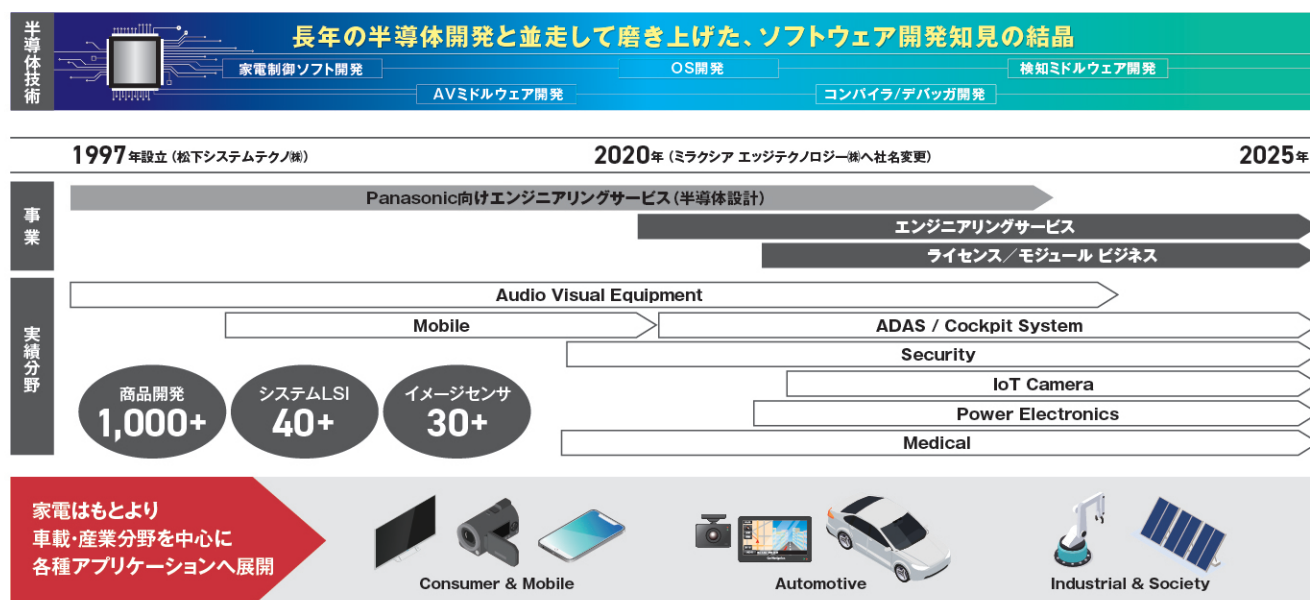


誰もが組み込み開発ができる世界の実現

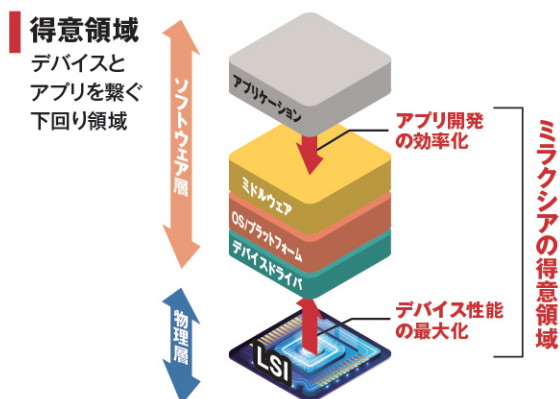
それがミラクシアの目指す姿です。私たちは、半導体ハード開発者と長年にわたり培ってきたソフトウェア開発の知見を、「デバイスシステムインテグレーション (DSI)」というスキルとして体系化。高効率・高品質なデバイスシステムの構築を支える、組み込みソフトウェアおよびシステム開発事業を展開しています。

家電はもちろん自動車・車載・産業用機器などの幅広い分野での受託開発事業を中心に、開発担当者を支援する多彩なソリューションを提供しています。

40種以上のシステムLSI開発と1,000種以上の商品開発へ参画 組み込みの観点から商品の競争力強化／開発効率向上の取り組みを推進

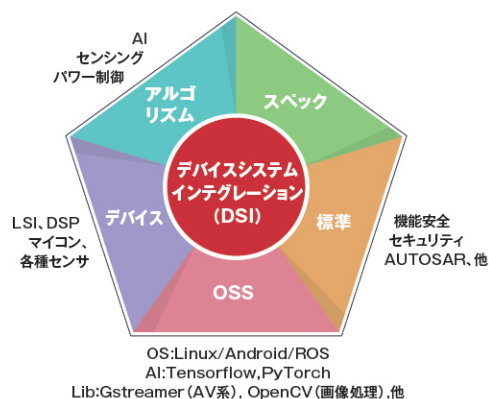


デバイス性能の最大化、アプリ開発の効率化を実現するデバイスシステムインテグレーション (DSI) スキル



デバイスシステムインテグレーション (DSI)

各種要件を考慮して最適なデバイスシステムを構築



会社情報

会社名	ミラクシア エッジテクノロジー株式会社 Miraxia Edge Technology Corporation
本社所在地	〒617-8520 京都府長岡京市神足焼町1
事業所所在地	新横浜事業所 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目9-18 新横浜TECHビル
設立	1997年1月10日
事業内容	● 車載/産業/民生分野向けの組込みソフトウェア開発、 及びソフトウェアとハードウェアを組み合わせたシステム設計 ● ソフトウェアライブラリの開発及びライセンス販売 ● モジュール製品の開発及び販売
開発拠点	長岡京(京都)、新横浜(横浜)
資本金	2億円 (Winbond Electronics Corporation 全額出資)
従業員数	402人 (2025年11月1日現在)
役員	代表取締役会長 林正恭 代表取締役社長 中澤 省吾 取締役 小林 平治 取締役 焦子忻 取締役 邱仁鈿 取締役 陳沛銘 取締役 林任烈 監査役 西田 昭彦 監査役 楊金鳳

事業内容

● 技術・受託開発事業

BSP開発
イメージング・AI技術
パワーエレクトロニクス
モビリティ
スマートFA
センシング

● ソリューション事業

沿革

- 1997年 会社設立 松下システムテクノ株式会社
2014年 ソフトウェアライセンス、モジュールの販売を開始
2015年 パナソニック セミコンダクターソリューションズの
開発機能の一部を統合
2020年 ミラクシア エッジテクノロジー株式会社に社名変更

